

ESPAÑOL

Sebir-TSF, el primer alambre para estampación en frío sin fosfato, se consolida en el mercado internacional

La empresa española Sebir S.A., creadora de TSF, el primer alambre trefilado a alta presión y que permite la supresión del recubrimiento superficial del fosfato en todos los pasos de estampación en frío, ha consolidado el producto a nivel internacional. Este producto exclusivo e innovador aporta significativas ventajas medio ambientales, mejora la respuesta de la calidad en el producto final y genera un ahorro económico sustancial en la estampación.

El producto TSF se presentó en el Salón Internacional Wire de Düsseldorf en 2012 y, desde entonces, se ha consolidado en el mercado. Este producto exclusivo de SEBIR supone mejoras medioambientales y de calidad para la industria. En el área económica, TSF consigue importantes ahorros ya que, con su uso, se elimina el proceso de desfosfatación.

TSF aumenta la vida tanto de los aceros refractarios de los hornos como de los aceites de estampación, y mejora la productividad de las estampadoras. A nivel medioambiental, el uso de TSF elimina las aguas residuales contaminadas con nitratos o metales pesados, elimina también todos los residuos de desfosfatación, y minimiza la cantidad de aceites contaminados.

La excelente calidad que ofrece este alambre trefilado sin fosfatos, y que hace aumentar la capacidad de deformación admisibles del material, minimiza la aparición de grietas, mejora la geometría de las piezas estampadas, y aumenta tanto la capacidad de extrusión, como la velocidad del roscado.

Con más de 40 años de historia, Sebir S.A., trabaja orientando toda su organización a la calidad total, buscando la excelencia y potenciando la cadena de valor desde el proveedor. SEBIR trabaja aprovechando todas las ventajas competitivas que puedan proporcionar al departamento de I+D+i y pone en valor el trabajo de relación y colaboración con los clientes, estando así continuamente buscando novedades que puedan proporcionar beneficios conjuntos.

ENGLISH

Sebir-TSF, the first drawn wire for phosphate-free cold stamping, strengthens its position in the international market

Some years ago, Spanish company Sebir S.A. created TSF : the first high-pressure drawn wire which allows the removal of superficial phosphate coating in all the steps of cold stamping. Nowadays, Sebir S.A. has consolidated its product internationally. This exclusive and innovative product provides relevant environmental benefits, improves quality in the final product and leads to significant cost savings in the stamping process.

TSF was presented in 2012, at Düsseldorf Wire international trade fair. Since then, it has strengthened its position in the market. This exclusive SEBIR product implies environmental and quality improvements for this industry. From an economic perspective, TSF achieves important cost savings as, by using it, the de-phosphating process disappears.

On the other hand, TSF increases the operating life of both heat-treatment furnaces and stamping oils, and improves the productivity of forming process. Environmentally speaking, the use of TSF eliminates residual polluted waters, containing nitrates or heavy metals. Furthermore, it eliminates all the de-phosphating residues and it minimizes the amount of polluted oils.

The excellent quality offered by this drawn wire for phosphate-free cold stamping improves the acceptable deformation ratio of materials. Moreover, it keeps the cracks to a minimum, improving the geometry of stamping parts. Besides, it improves both extrusion capacity and thread speed.

With more than 40 years of experience, Sebir S.A. aims at achieving the highest standards of organization and trying to reach excellence by fostering the value chain from the supplier. SEBIR makes the most of the competitive advantage of its Research and Development department. Furthermore, it focuses on feedback and collaboration with its clients, constantly looking for updates which may lead to common benefits.